厦门市海沧区人民政府文件

厦海政规〔2023〕10号

厦门市海沧区人民政府关于 印发进一步扶持海沧区集成电路产业 发展办法的通知

各街道办事处，区直各办、局，各有关单位：

《进一步扶持海沧区集成电路产业发展办法》已经区政府研究同意，现予以印发，请遵照执行。

厦门市海沧区人民政府

2023年10月24日

（此件主动公开）

进一步扶持海沧区集成电路产业发展办法

第一章 总则

第一条 为加快推动我区集成电路产业发展，贯彻落实《厦门市集成电路产业发展规划纲要》（厦委办发〔2016〕32号）、《厦门市人民政府关于进一步加快推进集成电路产业发展若干措施的通知》（厦政规〔2022〕11号）和《厦门市集成电路产业发展规划海沧区实施方案》（厦海委〔2017〕20号）等文件精神，特制定本办法。

第二条 本办法所称集成电路企业是指具有独立法人资格与固定经营场所，专门从事集成电路领域（包括但不限于EDA工具、IP、逻辑电路、模拟/功率电路、存储器、特色工艺半导体、宽禁带半导体、微机电系统（MEMS）与智能传感器、基础电子元器件、Mini/Micro LED、OLED、激光显示等）设计、制造、封装测试、装备与材料等生产及研发等经营活动的企业。

第二章 投融资政策

第三条 鼓励银行业金融机构对集成电路企业给予信贷支持，设立集成电路专项贷款和面向集成电路企业设计金融产品。支持政府性融资担保机构为集成电路中小企业贷款提供担保，按年度实际担保额的1%给予担保机构补助。

第三章 科研支持

第四条 对集成电路企业、高校或科研院所研发多项目晶圆（MPW）的，分别按直接流片费用的70%、80%给予补助；对首次完成全掩膜（FULL MASK）工程产品流片（含Foundry IP授权、

掩膜版制作、晶圆片等，晶圆片数量超过 12 片的，按 12 片核算)的，按流片费用的 30%给予补助，其中对于利用符合条件的集成电路生产线进行流片的按 50%给予补助；每家年度补助总额最高不超过 600 万元。

第五条 集成电路设计企业首年度利用符合条件的生产线进行封装测试的，按封装测试费用的 50%给予补助；每家年度补助总额最高不超过 150 万元。

第六条 集成电路企业购买 IP 用于集电路线宽小于 0.25 微米（含）等高端芯片研发的，给予 IP 购买直接费用 40%的补助，每家年度补助总额最高不超过 300 万元。对集成电路设计企业购买 EDA 设计工具软件的，按照实际发生费用给予不超过 40%的补助，每家年度补助总额最高不超过 300 万元。

第四章 成长激励

第七条 对年销售额首次超过 1 亿元的系统（整机、终端、模组）企业采购符合条件的集成电路企业芯片的，按采购额的 15%给予补助，每家年度补助总额最高不超过 150 万元，补助累计不超过 3 年。

第五章 降低企业运营成本

第八条 集成电路企业租用符合条件的生产、研发或办公场地的，按照“先缴后补”方式，给予前三年实际租金 100%补助、第四年至第五年给予 50%补助，每家租用生产、研发或办公场地的补助建筑面积最高不超过 1000 平方米。同一家企业租用生产、研发或办公场地的，按照“就高不重复”的原则执行。

第九条 支持集成电路企业拓展国内外市场，对参加国内外

专业展会的集成电路企业给予展位费、特装搭建的费用 50%的补助，单次最高不超过 25 万元，年度补助总额最高不超过 50 万元。

第十条 对集成电路中小企业通过担保机构贷款融资的，按企业缴交担保费的 50%给予补助，每家年度补助总额最高不超过 100 万元。

第六章 附则

第十一条 本办法所需资金由区财政统筹落实，由各相关部门列入年度预算并分别具体落实；科研支持、成长激励、降低企业运营成本等由海沧区工业和信息化局负责兑现；投融资政策由海沧区金融办负责兑现。

第十二条 申请企业应当实际开展业务工作、如实提供有关材料，采取弄虚作假等不诚信手段骗取扶持资金的，一经发现，兑现部门有权追回企业已享受的扶持资金，对市、区政策中的同一事项存在差异的，按“就高不重复”原则，鼓励企业优先申请市级政策，区级补足差额。

第十三条 本办法发布实施时，原有集成电路产业政策中涉及享受年限规定的，已享受年限合并延续计算并在本办法有效期内按本办法执行。

第十四条 本办法由海沧区工业和信息化局、海沧区金融办负责解释。

第十五条 本办法自 2023 年 11 月 25 日后实施，有效期五年。